

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2025年6月1日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案。2025年6月20日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案。

2025年9月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具《关于同意杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2025〕2334号），同意公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行。本次定向发行的发行股份数量为203,333,331股，募集资金610,000,000.00元。

2025年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金进行审验，并出具《验资报告》（天健验字〔2025〕300号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并于2025年9月30日与主办券商及公司存放募集资金的商

业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金进行专户管理。专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (元)
1	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	中信银行杭州玉泉支行	8110801012303235823	0.00
2	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	招商银行杭州拱墅支行	571912713210001	0.00
3	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	交通银行杭州秋涛路支行	331066150015003136864	0.00
4	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行	1202021129800306641	0.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金置换情况

2025 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金共计人民币 290,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	已使用自筹资金支付金额	拟使用募集资金置换金额
1	预先支付货款、支付员工工资等	291,389,477.14	290,000,000.00

该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，同时符合公司确定的募集资金用途，不影响募集资金投资

项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2025年11月17日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-021）。同日，财通证券出具《财通证券股份有限公司关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

（二）本年度募集资金使用情况及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	610,000,000.00
减：发行费用	0.00
（二）募集资金净额	610,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	40,549.53
（三）合计	610,040,549.53
（四）已使用募集资金金额	610,000,000.00
其中：补充流动资金	500,000,000.00
偿还借款/银行贷款	110,000,000.00
（五）募集资金专户销户利息转出	40,549.53
（六）截至2025年12月31日募集资金余额	0.00

（三）募集资金专户注销情况

2026年1月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》。公司募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，2025年12月18日，公司将募集资金专户利息余额40,549.53元全部转出并完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与主办券商及公司存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，2025年12月18日，公司将募集资金专户利息余额40,549.53元全部转出并完成了上述募集资金专户的注销手续。2026年1月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》。截至目前已经补充审议并披露。除此事项外，公司2025年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026年3月24日